



平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年8月14日

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス

上場取引所 東

コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山村 章

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 文 TEL 03-3281-8186

四半期報告書提出予定日 平成30年8月14日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無

四半期決算説明会開催の有無： 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第1四半期	22,672	9.0	2,707	19.4	1,785	2.2	683	△26.2
30年3月期第1四半期	20,793	20.8	2,268	38.5	1,747	77.5	925	103.9

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 △710百万円 (ー%) 30年3月期第1四半期 △88百万円 (ー%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第1四半期	18.47	18.44
30年3月期第1四半期	29.85	29.64

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
31年3月期第1四半期	124,173	50,775	40.4	1,355.50
30年3月期	118,457	51,812	43.3	1,386.51

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 50,157百万円 30年3月期 51,305百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期	ー	12.00	ー	12.00	24.00
31年3月期	ー				
31年3月期(予想)		12.00	ー	12.00	24.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 平成31年3月期の連結業績予想（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	46,000	7.0	4,600	2.3	3,900	1.1	2,400	4.3	64.86
通期	98,000	8.2	9,800	16.2	8,500	18.7	5,300	97.9	143.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	31年3月期1Q	37,096,702株	30年3月期	37,096,702株
② 期末自己株式数	31年3月期1Q	93,568株	30年3月期	93,568株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	31年3月期1Q	37,003,134株	30年3月期1Q	31,020,422株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更)	8
(追加情報)	8
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における経済状況は、米国経済では景気拡大により金利の追加利上げが実施されました。中国経済は、一定の経済成長が維持されていますが、先ごろ発動された米中の貿易摩擦の影響が、今後の中国経済の減速など不透明感を強めております。我が国では、企業活動に改善の兆しが見られましたが、個人消費意欲は足踏みの状況からやや弱含み基調となりました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、海外での半導体メモリや液晶・有機ELパネルなどの設備投資が継続しており、設備稼働率も一定の水準で推移しました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、大型液晶・有機ELパネル製造装置向けの真空シールが好調であり、エンジニアリング・サービスの受託製造も増加しています。また、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカーからの需要が強いマテリアル製品の販売は、好調に推移しましたが、概ね計画のとおりとなりました。太陽電池関連事業におきましては、太陽電池市況は春節明けから価格下落の一途となり、当社グループではシリコン製品の生産調整の実施、従前に生産した製品在庫の処分に踏み切りました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は22,672百万円（前年同期比9.0%増）、営業利益は2,707百万円（前年同期比19.4%増）、経常利益は為替差損825百万円の発生などから1,785百万円（前年同期比2.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は683百万円（前年同期比26.2%減）となりました。

当第1四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

なお、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンウエーハ加工、装置部品洗浄などです。

主力の真空シールは、半導体および有機ELパネルなどの製造装置内に装着され、密封空間を保持する機能部品です。半導体の微細化投資や有機ELパネルの投資が継続された結果、同部品が伸長しました。一方、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品など半導体のウエーハプロセスに使用されるマテリアル製品は、データセンター等のサーバー用DRAMやスマートフォン用フラッシュメモリなどの需要が旺盛であり、デバイスメーカー各社の装置稼働率は一定の水準で推移しました。当社グループではマテリアル製品の製造ラインの拡張を実施中です。また、新たにセグメント入りした装置部品洗浄（半導体製造装置、液晶パネル製造装置等の部品洗浄）は、上海、天津、四川、大連に加え、安徽省に5拠点目となる新たな工場を建設中です。

当該事業は、半導体製造装置の投資及び稼働率に連動しますが、底堅く推移いたしました。

この結果、当該事業の売上高は12,737百万円（前年同期比21.2%増）、営業利益は2,451百万円（前年同期比44.4%増）となりました。

(太陽電池関連事業)

当該事業の主な製品は、シリコン結晶製造装置、シリコン製品、石英坩堝などです。

太陽電池産業は、太陽光発電の設置量は拡大しておりますが、前年並みの需要の兆しが乏しく低調な市場環境でした。中国市場では価格競争が発生し、価格下落が進み当社のシリコン製品等の販売価格も下落したため、OEM向けを除き一時製造を半減させ生産調整を行いました。価格下落の進行から大きな損失を回避するため在庫処分に踏み切りました。

一方、シリコン結晶製造装置や消耗品である石英坩堝は、得意先への供給責任を果たしながら半導体用途へ移管が進んでおり、今後も事業構造改革を進めてまいります。

この結果、当該事業の売上高は3,036百万円（前年同期比30.8%減）、営業損失は285百万円（前年同期は222百万円の営業損失）となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

主力の自動車温調シート向けサーモモジュールは、北米市場及び欧州市場での自動車販売台数が前年比で減少し、顧客の在庫調整により影響を受けました。その他の用途では、移動通信システム、医療検査装置、バイオ関連機器など、概ね計画のとおりに移しました。パワー半導体用基板は、新たな顧客からの受注を得たことから増産体制構築のため新工場を7月に竣工致しました。磁性流体は、高位機種スマートフォンの販売台数が減少したことから、やや軟調に移しました。

当該事業の各製品は、景気に左右されにくい業種への販売を進めております。

この結果、当該事業の売上高は2,846百万円（前年同期比11.7%減）、営業利益は513百万円（前年同期比36.2%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ5,715百万円増加し、124,173百万円となりました。これは主に現金及び預金5,649百万円、有形固定資産815百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ6,751百万円増加し、73,397百万円となりました。これは主に社債（1年内償還予定を含む）3,250百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）4,937百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ1,036百万円減少し、50,775百万円となりました。これは主に利益剰余金239百万円が増加した一方、為替換算調整勘定1,430百万円が減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成30年5月15日の「平成30年3月期 決算短信」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,648,597	29,297,950
受取手形及び売掛金	20,700,345	20,329,804
商品及び製品	5,552,675	4,679,566
仕掛品	4,927,496	5,190,002
原材料及び貯蔵品	6,293,807	7,153,825
その他	6,560,609	5,900,032
貸倒引当金	△856,933	△827,807
流動資産合計	66,826,597	71,723,374
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	10,355,319	9,951,071
機械装置及び運搬具（純額）	12,564,877	12,717,038
工具、器具及び備品（純額）	7,304,868	7,204,653
土地	1,589,488	1,587,455
リース資産（純額）	540,941	501,891
建設仮勘定	11,186,361	12,395,495
有形固定資産合計	43,541,856	44,357,607
無形固定資産		
のれん	378,031	315,988
その他	2,544,449	2,596,127
無形固定資産合計	2,922,480	2,912,115
投資その他の資産		
その他	6,046,327	6,041,865
貸倒引当金	△879,586	△861,872
投資その他の資産合計	5,166,741	5,179,993
固定資産合計	51,631,078	52,449,716
資産合計	118,457,676	124,173,091

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	18,419,085	17,816,642
短期借入金	5,874,778	6,533,647
1年内償還予定の社債	588,000	1,238,000
1年内返済予定の長期借入金	5,055,648	5,179,737
未払法人税等	1,282,068	959,629
賞与引当金	1,196,112	955,219
その他	11,061,818	10,353,751
流動負債合計	43,477,512	43,036,627
固定負債		
社債	2,418,000	5,018,000
長期借入金	11,478,012	16,291,456
退職給付に係る負債	535,719	537,686
役員退職慰労引当金	12,900	14,250
訴訟損失引当金	1,158,430	1,197,123
資産除去債務	84,645	84,807
その他	7,480,014	7,217,206
固定負債合計	23,167,722	30,360,530
負債合計	66,645,234	73,397,158
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,607,927	17,607,927
資本剰余金	18,421,177	18,420,436
利益剰余金	7,912,843	8,152,370
自己株式	△86,644	△86,644
株主資本合計	43,855,303	44,094,088
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	174,758	213,819
為替換算調整勘定	7,411,644	5,981,259
退職給付に係る調整累計額	△136,480	△131,364
その他の包括利益累計額合計	7,449,922	6,063,713
新株予約権	4,250	4,250
非支配株主持分	502,965	613,879
純資産合計	51,812,442	50,775,932
負債純資産合計	118,457,676	124,173,091

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	20,793,281	22,672,929
売上原価	14,807,803	15,693,743
売上総利益	5,985,477	6,979,186
販売費及び一般管理費	3,717,325	4,272,079
営業利益	2,268,151	2,707,106
営業外収益		
受取利息	8,826	4,719
持分法による投資利益	49,391	142,739
その他	83,812	90,037
営業外収益合計	142,031	237,495
営業外費用		
支払利息	157,559	161,400
為替差損	336,750	825,682
その他	168,179	171,964
営業外費用合計	662,489	1,159,048
経常利益	1,747,692	1,785,554
特別損失		
固定資産処分損	—	66,737
投資有価証券評価損	19,157	—
訴訟損失引当金繰入額	—	63,896
特別損失合計	19,157	130,633
税金等調整前四半期純利益	1,728,535	1,654,920
法人税等	777,462	977,584
四半期純利益	951,072	677,335
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	25,156	△6,228
親会社株主に帰属する四半期純利益	925,916	683,564

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
四半期純利益	951,072	677,335
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	17,379	39,060
為替換算調整勘定	△1,061,429	△1,410,546
退職給付に係る調整額	1,966	5,116
持分法適用会社に対する持分相当額	2,260	△21,541
その他の包括利益合計	△1,039,823	△1,387,912
四半期包括利益	△88,750	△710,576
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△111,402	△702,645
非支配株主に係る四半期包括利益	22,652	△7,931

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)

「税効果会計に係る会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日。以下「税効果適用指針」という。）」を、税効果適用指針第24項の定めについて当第1四半期連結会計期間より適用しております。

なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間（自平成29年4月1日 至平成29年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体 等装置関連 事業	太陽電池 関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高								
(1)外部顧客への 売上高	10,513,521	4,386,429	3,223,483	18,123,434	2,669,847	20,793,281	—	20,793,281
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	13,109	—	—	13,109	—	13,109	△13,109	—
計	10,526,630	4,386,429	3,223,483	18,136,543	2,669,847	20,806,390	△13,109	20,793,281
セグメント利益又 は損失 (△)	1,698,554	△222,008	804,891	2,281,437	△4,203	2,277,234	△9,082	2,268,151

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理等の事業を含んでおります。
- 2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△9,082千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

「II 当第1四半期連結累計期間 2. 報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりであります。

II 当第1四半期連結累計期間（自平成30年4月1日 至平成30年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体 等装置関連 事業	太陽電池 関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高								
(1)外部顧客への 売上高	12,737,708	3,036,608	2,846,867	18,621,184	4,051,744	22,672,929	—	22,672,929
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	61,747	—	—	61,747	—	61,747	△61,747	—
計	12,799,456	3,036,608	2,846,867	18,682,932	4,051,744	22,734,677	△61,747	22,672,929
セグメント利益又 は損失 (△)	2,451,918	△285,906	513,429	2,679,441	42,443	2,721,884	△14,777	2,707,106

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失 (△) の調整額△14,777千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益又は損失 (△) は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間より、事業セグメントの区分を見直し、従来、洗浄事業(半導体製造工程で使用される治具等の再生事業)は、中国子会社での独自事業として行っており、「その他」の事業として管理しておりましたが、事業規模が大きくなり全社的な主要事業として管理することとしたため、製品用途・販売先業種が類似している「半導体等装置関連事業」に含める事といたしました。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分に基づいて作成しています。